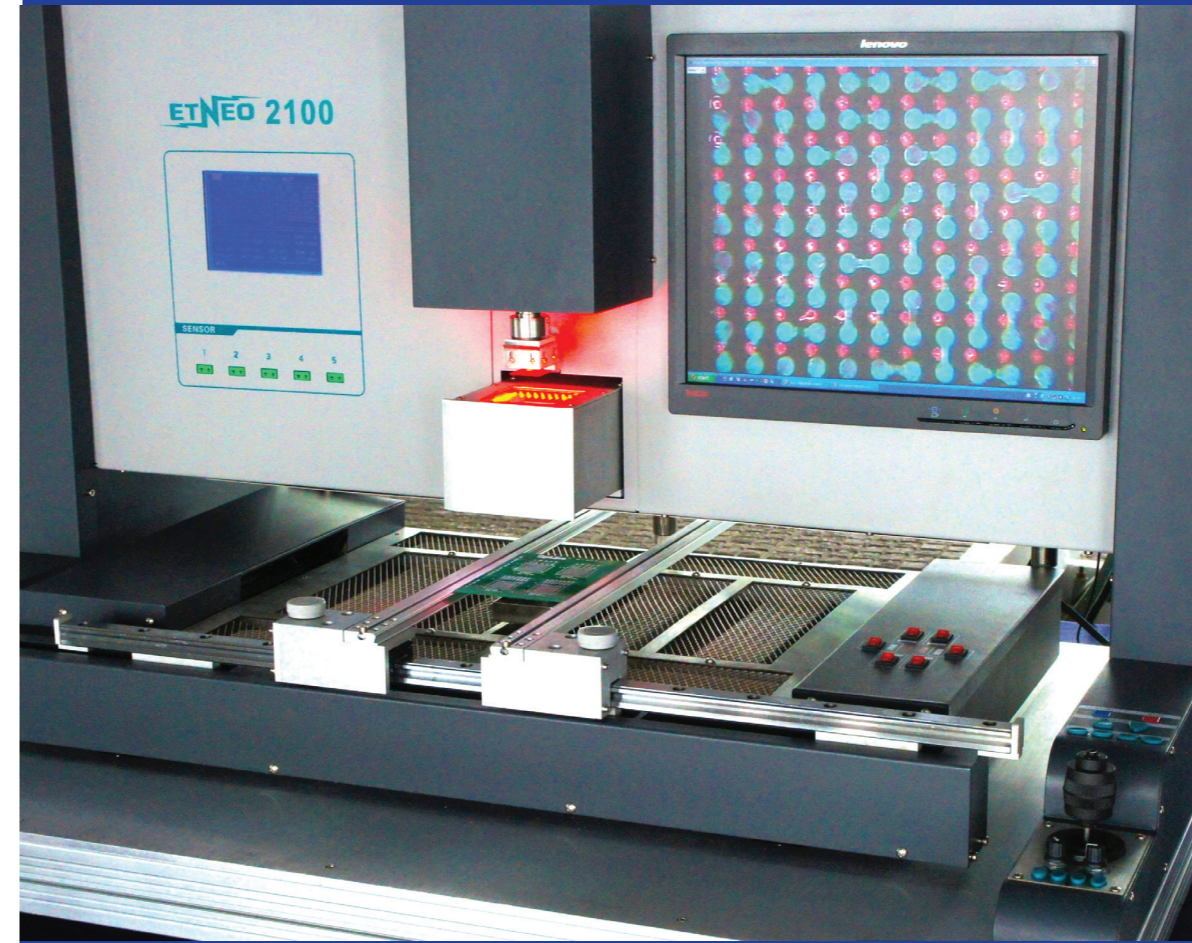


MADE in ETNEO Design in Italy



ETNEO ITALIA srl
Polo Scientifico e Tecnologico
28100 NOVARA - Italy
Via G. Bovio, 6
Tel. +39 0321 697200
Fax +39 0321 688515
info@etneo.com
etneo.com



BGA PROCESS AUTOMATION
REWORK - SOLDERING - REPAIR

ROBOT SELETTIVI PER IL REWORK DI BGA SMT
SELECTIVE REWORK

follow the leaf

Rework di BGA e package complessi in produzione

I Sistemi Etneo per la rilavorazione dei componenti Ball grid array sono macchine professionali con struttura compatta e robusta che assicurano una perfetta integrazione di allineamento ottico, meccanismo di posizionamento e sistema di riscaldamento che rendono semplice ed ottimale il re-work dei componenti.

Elevata automatizzazione. Lo spostamento della resistenza "TOP" è servo controllato ed automatico, (movimento su e giù e sollevamento dopo la dissaldatura del BGA).

Eccellente disegno della struttura per il fissaggio del PCB, che risulta estremamente facile da posizionare e rimuovere.

L'integrazione tra l'elevata area di preriscaldamento ed il riscaldamento a sezioni ad aria calda minimizza le differenze di temperatura tra il packaging del BGA e le pads sulla scheda. Questo sistema non solo previene la deformazione del PCB, ma accorcia il tempo di saldatura del BGA riducendo i rischi di danneggiamento del BGA o del PCB.



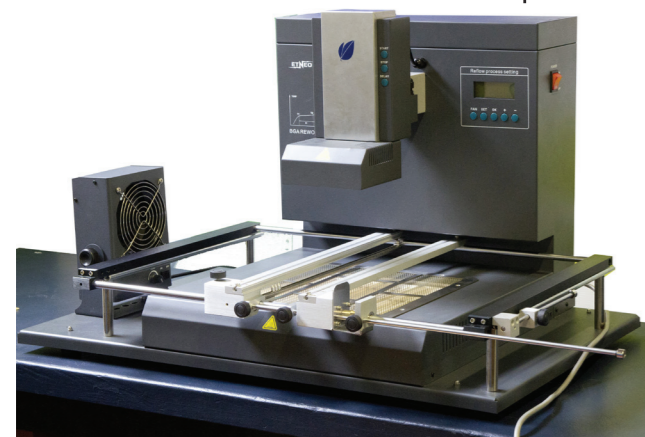
ET A-A10

Hot Air

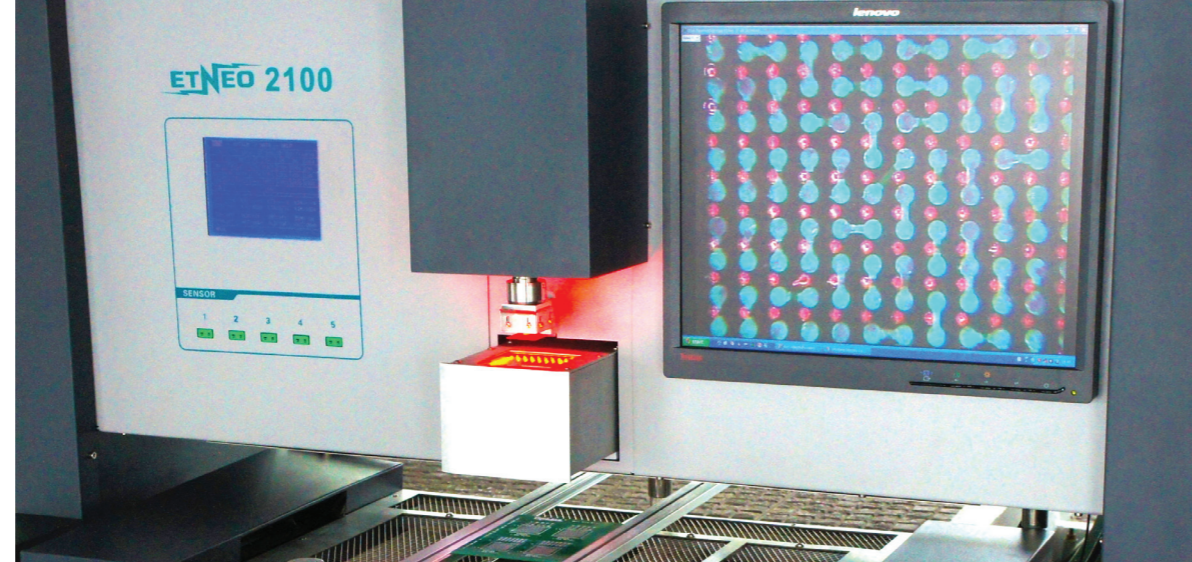


ET7710

Infra Red



ET 7610

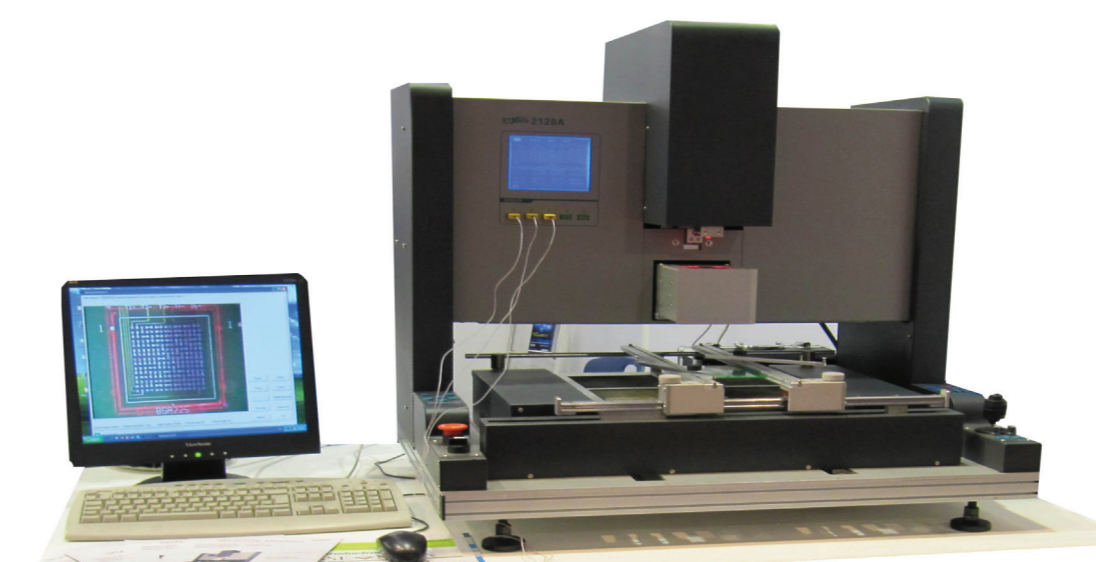


Robot ETA-A20

Caratteristiche Principali:

1. Utilizzano ventole "brushless" DC ad elevata potenza, niente aria compressa; la temperatura è controllata da sensori di rilevamento in tempo reale a circuiti to chiuso; il sistema è in grado di generare un'elevata quantità di aria calda.
 2. Controllo del preriscaldamento ad infrarosso separato.
 3. Varietà di ugelli in materiali adeguati disponibile, facili da sostituire.
 4. Le staffe porta scheda sono aggiustabili e gestite da motore automatico.
 5. Possibilità di settare programmi per controllare la temperatura "TOP" & "BOTTOM" dell'aria. La temperatura "TOP" & "BOTTOM" dell'aria, che risulta quindi precisa ed uniforme.
 6. Una potente ventola raffredda la scheda dal "BOTTOM" molto rapidamente.
 7. Con l'ausilio del "QUICKSOFT" è veramente semplice operare con il software della macchina. Le operazioni possono essere protette con password per evitare modifiche indesiderate dei processi.
- Il sistema utilizza una grande superficie di preriscaldamento ad infrarosso, dove le resistenze centrali sono sempre in funzione mentre è data all'operatore la scelta di utilizzare i gruppi resistivi laterali, tramite l'apposito controllo laterale a pulsanti. Quindi l'operatore in qualunque momento può decidere la potenza da usare in relazione ai materiali su cui si effettua rework, lo spessore e le dimensioni della scheda.
- Tutti gli assi X,Y e Z utilizzano un sistema di precisione orbitale lineare e di cursori di assoluta accuratezza. Si possono fare aggiustamenti di massima in manuale con relativa precisione, mentre grazie al "joystick" è possibile effettuare tutte le regolazioni di estrema ed assoluta precisione con il motore automatico controllato.

ETA-A20	SPECIFICHE
Alimentazione	220/230 V AC - 50-60Hz - 5KW
Max dimensioni PCB	600*500mm
Min IC dimens. - Max IC dimens	2*2mm / 60*60mm
Dimens. pre-riscaldamento inferiore	550*450mm
Finestra display LCD	100*75mm 16*2 characters
Accuratezza di montaggio	0.025mm
Temperatura Aria calda Top	500 C° (Max)
Temperatura pre riscaldamento aria	500 C° (Max)
Potenza resistenza Top - Bottom	800 W - 800 W
Potenza pre-riscaldamento inferiore Infrarosso	3200 W
Velocità aria raffreddamento	3.5/min
CCD Camera Hi Resolution	Auto
Termocoppie K esterne	5 pcs.
RS-232C	connessione a PC
Dimensioni macchina / Peso	1150(L)*800(W)*800(H)mm / 120Kg



Robot EA-A10

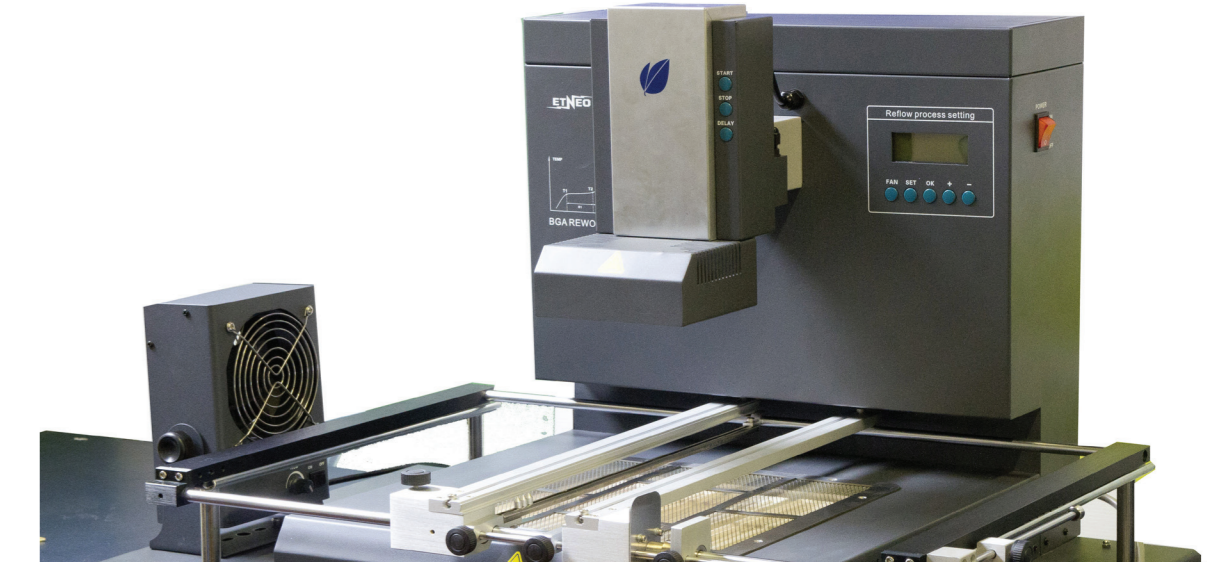
Caratteristiche Principali:

1. Usa ventole "brushless" DC ad elevata potenza, niente aria compressa; la temperatura è controllata da sensori di rilevamento in tempo reale a circuito chiuso; il sistema è in grado di generare un'elevata quantità di aria calda.
 2. Controllo del preriscaldamento ad infrarosso separato.
 3. Varietà di ugelli in materiali adeguati disponibile, facili da sostituire.
 4. Le staffe porta scheda sono aggiustabili e gestite da motore automatico.
 5. Possibilità di settare programmi per controllare la temperatura "TOP" & "BOTTOM" dell'aria. La temperatura "TOP" & "BOTTOM" dell'aria, che risulta quindi precisa ed uniforme.
 6. Una potente ventola raffredda la scheda dal "BOTTOM" molto rapidamente.
 7. Con l'ausilio del "QUICKSOFT" è semplice operare con il software della macchina. Le operazioni possono essere protette con password per evitare modifiche indesiderate dei processi.
- Le caratteristiche sono similari al modello ETA-A20 tranne che per un'area di lavoro più piccola 300 x 300 mm e potenza inferiore di 1700W e Superiore di 700W.

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLO ET 7710

1. Elevata Automazione - Processi di Dissaldatura - Pick Up e Riposizionamento del componente con un tasto.
2. Non necessita di sorgente di aria compressa, grazie alla elevata generazione interna.
3. Sette aree di setting temperatura per reflex BGA, multilayer BGA and metal shielding case.
4. Disegno innovativo che integra sistemi di riscaldamento ed allineamento.
5. Sistema a doppio colore led per facile gestione di allineamento e visione.
6. Tutti i parametri di gestione facilmente ed immediatamente settabili e memorizzabili.
7. Interfaccia software quicksoft per la gestione e le analisi di processo.
8. Ampia gamma di ugelli di precisione.

Alimentazione	220V AC, 50Hz, 3KW -
Max PCB dimensione	400*300mm
Min IC dim.	2*2mm - Max IC dim. 60*60mm
Dim del bottom heater	330*360mm
LCD Schermo	100*75mm 16*2 characters
Accuratezza di montaggio	±0.025mm -
Temperatura Aria Calda	500°C(Max)
Temperatura preriscaldamento inferiore	500°C(Max)
Potenza top heater	800Watt
Potenza bottom heater	800Watt
Potenza del bottom IR - pre-riscaldamento	1600Watt
Velocità ventola di raffreddamento	≤ 3.5m3 /min
Sensori tipo K esterni	3 pcs
Interfaccia comunicazione	RS-232C(connect with PC)
Dimensioni	650(L)*570(W)*500(H)mm
Peso	About 60kg



IR Rework & Tools



Forno da Banco tipo desktop

Forno per reflow di schede e per il reflow dei bumpers dei package ball grid array.

Profilatura programmabile per entrambe le funzioni.
Temperature uniformi per accurata profilatura
Visione real time con luce.
Ampio display digitale.

- Voltaggio: 220VAC
- Potenza resistenza superiore: 800watt
- Potenza resistenza inferiore: 400watt
- Range di temperature: da 50°C a 350°C
- Area di pre-riscaldamento: 130x130mm
- Canali di lavoro: 10
- Dimensioni: 40x29x20cm
- Peso: 9,0kg

BGA REBALLING & REWORK SERVICE

Etno Italia offre un accurato ed altamente professionale servizio di Rework di qualsiasi scheda e componente ed un reballing di Bga condotto con apparecchiature di saldatura sfere Laser e comprovato con documentazione risultati eseguita da procedure che includono macchine di controllo e validazione Raggi X.

CARATTERISTICHE MODELLO ET7610

Tecnologia Infrarosso Far Modulato per un'efficace controllo delle temperature.

Potenza max	2200Watt(max)
Potenza Bottom preriscaldamento	1500Watt(Infrared heating tube)
Potenza Top heating	720Watt (IR heating tube, Dim.: 60mm*60 mm)
Area pre riscaldamento bottom heater	260*260mm
Range movimento top heater	20-60mm
Tempo riscaldamenti del top heater	Approx 10s (DA temperatura ambiente to 230°C)
LCD display schermo Size:	65.7*23.5 (mm) 16*2 caratteri
Comunicazione	Standard RS-232C (Connect with PC)
IR temperatura sensor	0-300°C (Testing range)
Sensori esterni tipo K :	Opzionali
Dimensioni	33*38*44 (cm)
Peso	20Kg

Sistema per rework BGA economico

Macchina per rework di BGA economica, dotata di sistema ad aria calda per il riscaldamento superiore con profili settabili, sistema di preriscaldamento inferiore ad infrarosso e pratico supporto scheda.

Visitate il nostro sito per le Specifiche Tecniche

www.etneo.com/webstore/

